

电镀级活性氧化铜

产品名称	电镀级活性氧化铜
公司名称	昆山德阳新材料科技有限公司
价格	60.00/KG
规格参数	品牌:德阳 型号:YS-808
公司地址	花桥镇兆丰路8号
联系电话	400-1501-808 15250257568

产品详情

YS-808电镀级氧化铜、电镀级活性氧化铜、电镀级纳米活性氧化铜

YS-808电镀级氧化铜、电镀级活性氧化铜、电镀级纳米活性氧化铜与传统铜源相比的优势

- 1.采用YS-808电镀级氧化铜、电镀级活性氧化铜、电镀级纳米活性氧化铜，铜利用率高达100%:无阳极泥的产生，不会导致铜离子含量不稳定的情况。
- 2.采用YS-808电镀级氧化铜、电镀级活性氧化铜、电镀级纳米活性氧化铜，维护工作最少，生产效率更高，人工成本更低：不需停机维护，不需要周期性补充磷铜球等，降低了人工成本。
- 3.采用YS-808电镀级氧化铜、电镀级活性氧化铜、电镀级纳米活性氧化铜，缩短电镀时间，提高产出：采用氧化铜粉为铜源，电极使用寿命长，电流密度更高，可以大大缩短电镀时间，提高产出。

一、产品介绍：

电镀级氧化铜粉由高纯度电解铜加工制得，PCB行业镀铜制程（工艺）使用，可以达到更好的镀铜品质与更低的制造成本。产品研发的研发，由中科院博士带领专业队伍在高配置的德阳研发中心，利用各种尖端仪器设备，研发出的国家专利技术。

1、产品特性：

氧化铜含量极高杂质极低，含有极少量的水和杂质已经达到无法分离了。粉末状态，粒径小、反应溶解速率快。氯离子含量极低。与填孔药水溶解及配合性能好。

2、产品应用：

用于连续垂直电镀生产线，为了解决电镀填孔技术难题，应用于PCB版面电镀、HDI填孔电镀、BGA填

孔电镀、FPC、IC等。21世纪随着微电子技术的飞速发展，印制电路板制造向多层化、积层化、功能化和集成化方向快速的发展。为解决垂直镀铜不能完成的高技术、尖端电镀要求，比如高纵横比、深盲孔电镀，尤其是不溶性VCP线的技术出现。生产的高纯度、低杂质电镀级活性氧化铜粉，既能及时补充镀液铜离子，又保证药水的稳定性，保持产品质量的稳定性。提高PCB企业的生产效率，降低PCB企业的生产成本，提高其企业的产品质量。

3、产品优势：

高纯度、低杂质含量，可以得到镀铜最佳品质效果，并可以增长槽液（光亮剂）使用寿命，降低制造成本。

粒径小、拥有与填孔电镀槽液更快的反应溶解速率，更易维持镀液中所需铜离子浓度。氯离子含量低，有利于槽液中氯离子的稳定控制并达到最佳镀铜品质的效果。

技术支持 公司可以提供纳米活性氧化铜在电镀、催化、添加剂等中的应用技术支持，具体应用咨询请与销售部人员联系。

昆山德阳新材料科技有限公司为您提供全套的技术支持与服务。

按需定制，竭诚服务！

24小时免费咨询电话：400-1501-808。0512-36802566-127

手机：15250257568 咨询QQ：410569145